

目 录

一、 贸易合规	1
(一) 为进一步执行瓦森纳安排, BIS 修改商业管制清单	1
(二) 美国新任贸易代表称未准备取消对华关税	1
(三) 因涉嫌非法向华为出售硬盘, 希捷遭美国商务部调查	2
(四) BIS 就半导体制造和先进封装工艺供应链风险发布征求意见	2
二、 海外投资	3
(五) 美国商务部就通信技术和服 务交易预先批准程序发布拟议规 则	3
(六) 美国商务部向多家中国企业发出传票审核其信息通信技术及 服务的交易	4
(七) 美国证监会发布实施《外国控股公司责任法》的暂行规定	5
(八) FCC 开始取消两家中资公司的运营许可证	5
三、 立法动态	6
(九) 多部门联合发布促进集成电路产业发展进口税收政策	6
(十) 最高法院称将加强高端芯片方面的司法保护	8

(十一) 美商务部长会见 SIA 成员	9
(十二) FCC 对 5G 新立法表示赞扬	9
四、 业界动态	10
(十三) 美光将出售其在犹他州的芯片工厂	10
(十四) 日本找台积电助阵开发 2 纳米以下制程	11
(十五) 中芯国际在深圳投资建设新工厂	12
(十六) Intel 将启动芯片外包晶圆代工等新 IDM2.0 计划	13

一、 贸易合规

(一) 为进一步执行瓦森纳安排，BIS 修改商业管制清单ⁱ

当地时间 3 月 29 日，美国商务部产业与安全局(BIS)发布最终规则，修订商业管制清单(Commerce Control List, CCL)，并对出口管制条例(EAR)进行相关性修订，以进一步实施 2019 年 12 月瓦森纳会议对《关于常规武器和两用物项及技术出口管制的瓦森纳协定》(Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies)下“关于两用物项和技术的瓦森纳安排清单”(Wassenaar Arrangement List of Dual-Use Goods and Technologies)进行的修改。该修订于公布之日起生效。

本次修订的主要内容包括：

- 修订 22 个 ECCN 编码：0A502, 0A503, 0A606, 1A002, 1A005, 1A006, 1A613, 1B002, 1C001, 1C002, 1C006, 1C010, 2A001, 3B001, 3E002, 5A002, 6A004, 6A005, 6A008, 9A011, 9D515 和 9E003。
- 修订 CCL 第 2 部分第 5 类下的多项规定，包括多种报告要求，以减轻出口商的监管负担。

(二) 美国新任贸易代表称未准备取消对华关税ⁱⁱ

当地时间 3 月 30 日，《华尔街日报》报道称，美国新任贸易代表 Katherine Tai 表示，美国还没有准备好在近期内取消中国进口商品的关税，但可能会对与中国开展贸易谈判持开放态度。

Katherine Tai 在接受采访时表示，其承认对华关税会给美国企业和消费者造成损失，不过也有声音表示该关税也有助于保护公司免受外国补贴竞争的影响。她补充道，取消关税可能会损害经济，除非经过恰当沟通，能让相关人士做出适当调整。

(三) 因涉嫌非法向华为出售硬盘，希捷遭美国商务部调查

iii

当地时间 3 月 17 日，据外媒报道，美国商务部已开始对硬盘公司希捷(Seagate)展开调查，以确认希捷是否违反美国针对华为的出口禁令。据消息人士称，希捷被怀疑向华为出口了含有出口管制的微芯片硬盘。

对此调查传言，BIS 未有置评，希捷亦没有回复。

(四) BIS 就半导体制造和先进封装工艺供应链风险发布征求意见^{iv}

当地时间 3 月 15 日，BIS 在联邦公报上就半导体制造和先进封装供应链风险(Risks in the Semiconductor Manufacturing and Advanced Packaging Supply Chain)发布征求意见。本次征求意见提交截止日期为 2021 年 4 月 5 日。

本次征求意见的背景是拜登上月签署的第 14017 号总统行政令（《关于美国供应链的行政令》，详见本半月刊 2021 年 2 月第

2 期)。而征求意见则要求对美国的半导体制造和先进封装供应链造成影响的下述要素提供评论和意见：

- 半导体制造和先进封装供应链中的关键商品和材料；
- 关键制造工艺和其他技术（包括电子设计自动化软件和先进的集成电路封装技术）；
- 提供维持具有竞争力的半导体生态系统所需的关键技术人员（包括半导体制造所需的国内教育和制造劳动力技能）；
- 可能扰乱半导体供应链的风险或突发事件（包括国防、情报、网络、国土安全、健康、气候、环境、自然、市场、经济、地缘政治、人权或强迫劳动风险等）；
- 半导体供应链的复原能力；
- 对其他关键下游行业的潜在影响；
- 政策建议或立法、行政、监管等行动或建议；
- 与 14017 号行政令要求的半导体制造和先进包装供应链评估相关的任何补充意见。

二、 海外投资

(五) 美国商务部就通信技术和服 务交易预先批准程序发布拟议规则^v

当地时间 3 月 29 日，美国商务部在联邦公报上发布拟议规则，就通信技术和服 务供应链的许可程序(Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain: Licensing Procedures)征求公众意见。相关意见必须在 4 月 28 日之前提交。

2021年1月29日，美商务部发布了名为“确保通信技术和服
务供应链(Securing the Information and Communications Technology
and Service Supply Chain)”的暂行规定，该规定自3月22日起生
效。此项规定目的在于执行2019年5月17日发布的第13878
号行政令(Securing the Information and Communications
Technology and Services Supply Chain)，禁止某些通信技术和服
务交易(“ICTS交易”)，以应对国家安全威胁。此项规定将包括
中国在内的六国政府认定为“外国对手”，进而，美国商务部有
权认定并禁止某些与中国企业相关的ICTS交易。

根据1月的暂行规定，商务部将在5月19日前对申请预批准以
从事或继续进行ICTS交易的实体实施许可程序。本次拟议规则
就是旨在向公众对该等许可程序征求意见。

(六) 美国商务部向多家中国企业发出传票审核其信息通信 技术及服务的交易^{vi}

2021年3月17日，美商务部长发表声明，美商务部已向多家
中国企业发出传票，要求这些企业提供资料，以审查这些企业
涉及的信息通信技术与服务(Information and Communication
Technology and Service)交易是否有可能协助中国政府获取到敏
感信息，从而对美国构成“国家安全威胁”。美国商务部没有透
露这些公司的名称。

美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在声明中称：“美国
政府坚定地致力于采取全面的政府手段，以确保不受信任的公
司不能挪用、滥用数据，确保美国技术不被中国或其他国家黑
客进行恶意活动。”

此次行动与拜登上月签署的《关于美国供应链的行政令》政策导向一脉相承，并认为是对于该行政令的具体实施和执行手段之一。

(七) 美国证监会发布实施《外国控股公司责任法》的暂行规定^{vii}

美国时间 3 月 24 日，美国证监会(Securities and Exchange Commission, SEC)发布了实施《外国控股公司责任法》（“《问责法》”）的暂行规定(Interim Final Rule)。该暂行规定将在联邦公报公布后 30 天后生效，并同时征求公众意见，公众意见亦需在公布后 30 天内提交。

该项暂行规定未包括《问责法》所提及的强制退市要求。SEC 在暂行规定的新闻稿中称，《问责法》对 SEC 在法案生效后 90 天内出台实施规定的要求只限于材料提交和信息披露的要求，而并不适用于强制退市要求；SEC 正在“积极考虑”实施强制退市要求的途径，并预计将就此公开征求意见。

就《问责法》中规定的材料提交和信息披露要求，该暂行规定进行了更加细化的要求和说明。

(八) FCC 开始取消两家中资公司的运营许可证^{viii}

当地时间 3 月 17 日，美国联邦通信委员会(Federal Communication Commission, FCC)发布两则通告，宣布将开始启

动程序以撤销中国联通美洲公司(China Unicom Americas)和太平洋网络公司(Pacific Networks)及其全资子公司 ComNet 在美国提供电信服务的授权。在声明中, FCC 称, “促进国家安全是委员会公共利益责任的组成部分, 今天的行动旨在保护国家的电信基础设施免受潜在的安全威胁”。FCC 称上述企业为“间接并最终由中国政府拥有和控制”, 并表示 FCC“对中国国有企业的下属公司容易受到中国政府的剥削、影响和控制表示担忧”。

三、 立法动态

(九) 多部门联合发布促进集成电路产业发展进口税收政策

ix

3月29日, 财政部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》(“《通知》”), 明确了支持集成电路产业和软件产业发展有关进口税收政策。同时, 为落实前述文件, 财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策管理办法的通知》。

《通知》明确国家发展改革委等5部门制定并联合印发享受免征进口关税的集成电路生产企业、先进封装测试企业和集成电路产业的关键原材料、零配件生产企业清单; 并制定并联合印发享受免征进口关税的国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业清单。

《通知》规定, 对下列情形, 免征进口关税:

- (一) 集成电路线宽小于 65 纳米（含，下同）的逻辑电路、存储器生产企业，以及线宽小于 0.25 微米的特色工艺（即模拟、数模混合、高压、射频、功率、光电集成、图像传感、微机电系统、绝缘体上硅工艺）集成电路生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性（含研发用，下同）原材料、消耗品，净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件。
- (二) 集成电路线宽小于 0.5 微米的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品。
- (三) 集成电路产业的关键原材料、零配件（即靶材、光刻胶、掩模版、封装基板、抛光垫、抛光液、8 英寸及以上硅单晶、8 英寸及以上硅片）生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品。
- (四) 集成电路用光刻胶、掩模版、8 英寸及以上硅片生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的净化室专用建筑材料、配套系统和生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件。
- (五) 国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，以及符合本条第（一）、（二）项的企业（集成电路生产企业和先进封装测试企业）进口自用设备，及按照合同随设备进口的技术（含软件）及配套件、备件，但《国内投资项目不予免税的进口商品目录》、《外商投资项目不予免税的进口商品目录》和《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》所列商品除外。上述进口商品不占用投资总额，相关项目不需出具项目确认书。

(十) 最高法院称将加强高端芯片方面的司法保护^x

3月26日，最高人民法院召开新闻发布会，发布《最高人民法院关于人民法院为北京市国家服务业扩大开放综合示范区、中国（北京）自由贸易试验区建设提供司法服务和保障的意见》（“《意见》”）。

《意见》分六个部分共二十六条，明确了人民法院服务和保障北京“两区”建设的总体要求和重点领域的具体举措。具体来看，《意见》提到，注重保护涉及国家重大战略需求、重大科研项目和工程、关键核心技术以及优势产业等领域的发明创造，为营造良好创新创业生态、提高科技成果转化效能提供司法服务和保障。加强对量子信息、人工智能、高端芯片、区块链、生物医药、新材料等新科技革命和产业变革前沿领域的司法保护力度，依法保护对经济增长具有突破和带动作用的各类科技成果，总结提炼科技创新司法保护新规则。

充分发挥知识产权审判对科技创新的激励和保障作用，加强对发明专利、技术秘密、集成电路布图设计、植物新品种、计算机软件等案件的审理，促进技术和产业不断升级。强化司法反垄断和反不正当竞争，加强商业秘密司法保护，依法制止垄断和不正当竞争行为，维护公平有序的市场环境。

加大对知识产权侵权违法行为的惩治力度，贯彻落实知识产权惩罚性赔偿制度，切实提高侵权成本。依法通过证据保全等方式及时固定侵权证据，依法妥善运用诉前行为保全有效保护创新主体合法权益。加大刑事打击力度，有效发挥刑罚惩治和震慑知识产权犯罪的功能。

(十一) 美商务部长会见 SIA 成员^{xi}

美国当地时间 3 月 18 日，美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)与 SIA (Semiconductor Industry Association) 董事会的首席执行官和高级管理人员。新部长雷蒙多表示，半导体是美国第四大出口产品，对美国的经济竞争力和国家安全至关重要。美国需要在国内制造业、研究和劳动力方面进行强有力的投资，帮助加强美国在半导体制造和创新领域的全球领导地位。

拜登政府认为半导体是一个关键的供应链，该产业必须加强。但多年来，美国在生产上的投资不足，损害了创新优势，而其他国家则从美国的例子中吸取教训，增加了对该行业的投资。雷蒙多称应对半导体短缺和投资美国半导体技术制造业将是首要任务。

(十二) FCC 对 5G 新立法表示赞扬^{xii}

2021 年 3 月 25 日，美国联邦通信委员会专员布伦丹·卡尔 (Brendan Carr) 赞扬美国参议院通过的立法，该立法将提供资金来扩大消除数字鸿沟所需的熟练劳动力，并提升美国在 5G 领域的领导地位。

由参议员 Wicker, Sinema 和 Scott (SC) 提出的《促进少数族裔参与电信职业发展法案》(the Improving Minority Participation and Careers in Telecommunications, IMPACT)，将在 NTIA 设立一项赠款计划，向美国传统黑人院校、部落大学和其他机构提供资金，以发展电信职业培训项目。

“从目前美国的基础设施来看，美国拥有世界上最强大的 5G 平台。互联网供应商正在以前所未有的速度增加新的基站和安装光纤，这刺激了对更多熟练工人的需求。在如此多的美国人依赖互联网在家工作和利用远程医疗之际，满足这一需求将推动我们在 5G 领域的领导地位，并创造数千个新工作岗位，”Carr 说道。“我赞赏 Wicker 参议员和他的同事们应对这一劳动力挑战的领导能力，他们提出的立法将帮助创造数千个高薪工作岗位，同时缩小数字鸿沟，提升我们在 5G 领域的领导地位。”

Carr 领导了一项 5G 就业计划，旨在通过社区大学和职业学校开展立塔技术培训项目。这些项目现在已经在南卡罗莱纳、南达科塔、北卡罗莱纳和俄克拉何马州启动，更多的职业学校项目正在筹划中。



(十三) 美光将出售其在犹他州的芯片工厂^{xiii}

美国当地时间 3 月 16 日，美光在其官网宣布，退出 3D Xpoint 项目。该项目是美光 2015 年以来与英特尔共同合作开发的新型内存芯片技术。美光认为，3D Xpoint 没有带来足够的业务，因此前景并不美好。作为退出的一部分，美光将关闭并出售位于犹他州的芯片制造工厂，该工厂主要生产基于 Xpoint 技术的内存芯片，该出售计划在 2021 年内完成。

(十四) 日本找台积电助阵开发 2 纳米以下制程^{xiv}

日经新闻报导，日本正研拟产、官、学界携手开发新一代半导体技术的计划，由官方出资 420 亿日元，结合佳能等日商开发 2 纳米以下制程技术，并打算和台积电建立合作体系，借由开发先进半导体技术重振芯片业，未来也将设立实验用产线，开发精密制程的加工与洗净相关技术。

台积电已核准于日本投资设立 100% 控股子公司，实收资本额不超过 186 亿日元，用于扩展台积电 3D IC 材料研究。

日经新闻报导的消息传出后，市场关注台积电日本布局，是否会从材料研究延伸至先进制程研发。对此，台积电昨（23）日回应，“目前日本项目按照计划进行中”。

日本企业登记资讯显示，台积电在日本的办公据点多在横滨，除了神奈川县西区横滨市设有一个子公司之外，另有台积电日本设计技术公司也位于横滨市同样区位。此外，台积电已于 3 月 17 日完成设立登记台积电日本 3D IC 研发中心，地点就在台积电日本设计技术公司同一栋楼。

台积电在日本开出职缺所在地仍以横滨为主。近期在台积电日本设计中心的海外招募计划也是派驻横滨，主要找芯片物理设计工程师与记忆体设计工程师等，协助客户内部芯片测试与开发。

报导指出，日本佳能、东京威力科创（Tokyo Electron）以及 Screen 半导体解决方案公司，将与日本产业技术总合研究所携手合作，而这些公司也将与台积电及美国英特尔等半导体制造商，广泛地交换意见。

另一方面，随着 5G 技术的普及将持续提高效能半导体的需求，加上日前瑞萨电子（Renesas）工厂火警加剧车用芯片短缺困境，日本经产省也计划设立一个研究小组，以评估加强支持半导体供应网和先进半导体的政策战略。

日本的半导体产业虽然没落一段时间，但此次日本的政府、多家厂商合作以及携手台积电或将重振芯片产业。

(十五) 中芯国际在深圳投资建设新工厂^{xv}

中国最大、最重要的芯片制造商中芯国际(SMIC)正在深圳建设一座新工厂，将耗资 23.5 亿美元。公司将与中国南方城市深圳政府共同投资该项目。

深圳的新工厂将帮助中芯国际提高 28 纳米及以上芯片的产量。最近全球半导体的短缺使得汽车等一些行业需要芯片。但这些行业并不一定需要最新的芯片技术。

中芯国际表示，来自深圳政府的资金将使其“扩大生产规模，推进纳米技术服务，从而获得更高的回报。中芯国际将持有深交所 55% 的股份，而政府的投资部门将持有不超过 23% 的股份。剩余资金将来自第三方投资者。

(十六) Intel 将启动芯片外包晶圆代工等新 IDM2.0 计划^{xvi}

3月23日，英特尔 CEO 帕特·基辛格（Pat Gelsinger）阐述了如何通过制造、设计和交付领先产品，为利益相关方创造长期价值的未来路径。

在主题为“英特尔发力：以工程技术创未来”的全球直播活动上，基辛格分享了他的“IDM 2.0”愿景，宣布英特尔在制造业的扩张计划，将首先投资 200 亿美元（约合人民币 1303 亿元）在亚利桑那州建造两个新工厂；同时宣布英特尔代工服务，计划成为美国和欧洲的主要代工产能供应商，为全球客户提供服务。

为了加速实现英特尔 IDM 2.0 战略，基辛格宣布大幅扩大英特尔的生产能力。首先计划在美国亚利桑那州的 Octillo 园区新建两座晶圆厂。新晶圆厂将为英特尔现有产品和客户不断扩大的需求提供支持，并为代工客户提供所承诺的产能。

据悉，新建项目计划投资约 200 亿美元，预计将创造 3,000 多个高技术、高薪酬的长期工作岗位，以及 3,000 多个建筑就业岗位和大约 15,000 个当地长期工作岗位。

英特尔预计还将在美国亚利桑那州以外地区加快资本投资。基辛格表示，他计划在年内宣布英特尔在美国、欧洲以及世界其它地方的下一阶段产能扩张计划。

此外，为实现 IDM2.0 愿景，英特尔还与 IBM 宣布了一项重要的研究合作计划，专注创建下一代逻辑芯片封装技术。

值得一提的是，基辛格还重申，英特尔希望继续在内部完成大部分产品的生产。他透露，通过在重新构建和简化的工艺流程中增加使用极紫外光刻（EUV）技术，英特尔在 7 纳米制程方面取得了顺利的进展。英特尔预计将在今年第二季度实现首款 7 纳米客户端 CPU（研发代号“Meteor Lake”）计算芯片的 tape in（设计完成前的倒数第二个阶段）。

集成电路知识产权联盟 (ICIP Alliance)是在工业和信息化部科技司、工业和信息化部电子信息司及国家和地方相关主管部门指导下，由国家工业信息安全发展研究中心（工业和信息化部电子第一研究所，简称“国家工信安全中心”）牵头发起、于2016年1月20日正式成立的行业性、非营利性社会组织。国家集成电路产业投资基金股份有限公司为联盟名誉理事长单位，国家工信安全中心为联盟理事长单位，联盟秘书处设在国家工信安全中心-CIC 赛昇计世资讯。联盟成员覆盖集成电路设计、制造、封装、测试、相关装备和材料等产业链上下游企业及标准化、科研院所、相关软件开发、系统集成、互联网、内容与服务等企事业单位及社会团体组织，旨在整合全产业链资源，积极营造全产业链融入和适应国际竞争规则、尊重和加强知识产权保护、重视和加强合规管理的环境与氛围。

若有相关问题需要咨询或了解集成电路知识产权联盟，欢迎联系杨晓丽秘书长 65463692@qq.com 或中集知联小助手：ICIP_Alliance 或关注“中集知联”微信公众号查看更多信息。

美国奥斯顿律师事务所 (Alston & Bird LLP) 成立于 1893 年，在全球范围设有 13 家办公室，拥有约 800 多名律师，是一间面向全球的综合性国际律师事务所，为国内及跨国客户提供跨越多行业的最优法律服务。奥斯顿的国际贸易与合规团队是各大国际律所中少有的专业从事贸易合规相关业务的团队。它以美国华盛顿特区为核心辐射全球，为各类跨境商业活动提供合规咨询和法律支持，成功协助了各行业各类客户处理了各类复杂和敏感的国际贸易和法律合规事宜。依托原本就十分坚实的知识产权业务基础，半导体行业是奥斯顿国际贸易与合规团队近年来的执业重点，数年来已经为诸多业界领跑者提供了大量卓有成效的法律服务。

本半月刊中的任何内容并不构成本所的任何法律意见或建议。若对本半月刊的内容有任何问题或需要进一步了解奥斯顿律师事务所，欢迎联系李奕律师 yi.li@alston.com 或徐静婷 jing.xu@alston.com。

- ⁱ 参见: <https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/29/2021-05481/export-administration-regulations-implementation-of-wassenaar-arrangement-2019-plenary-decisions>。
- ⁱⁱ 参见: <https://www.wsj.com/articles/new-trade-representative-says-u-s-isnt-ready-to-lift-china-tariffs-11616929200>。
- ⁱⁱⁱ 参见: <https://www.washingtontimes.com/news/2021/mar/17/seagate-chip-sales-to-chinas-huawei-investigated>。
- ^{iv} 参见: <https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/15/2021-05353/risks-in-the-semiconductor-manufacturing-and-advanced-packaging-supply-chain>。
- ^v 参见: <https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/29/2021-06529/securing-the-information-and-communications-technology-and-services-supply-chain-licensing>。
- ^{vi} 参见: <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/03/us-secretary-commerce-gina-raimondo-statement-actions-taken-under-icts>。
- ^{vii} 参见: <https://www.sec.gov/news/press-release/2021-53>。
- ^{viii} 参见: <https://www.fcc.gov/document/fcc-initiates-proceeding-revoke-china-unicom-authorizations> 和 <https://www.fcc.gov/document/fcc-proceeding-revoke-pacific-networks-comnet-authorizations>。
- ^{ix} 参见: http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202103/t20210329_3677452.htm 和 http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202103/t20210329_3677454.htm。
- ^x 参见: <http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-292971.html>。
- ^{xi} 参见: <https://www.semiconductors.org/sia-statement-on-meeting-with-u-s-secretary-of-commerce-gina-raimondo>。
- ^{xii} 参见: <https://www.fcc.gov/document/carr-applauds-legislation-expand-5g-workforce>。
- ^{xiii} 参见: <https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-updates-data-center-portfolio-strategy-address-growing>。
- ^{xiv} 参见: <https://www.cnbeta.com/articles/tech/1105683.htm>。
- ^{xv} 参见: <https://new.qq.com/rain/a/20210320A08F6900>。
- ^{xvi} 参见: <https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/1960136440/74d54ef802700yf2t>。